NOVA COMPO-B PLUS+

TEK AŞAMALI UNIVERSAL BONDING

ASİTSİZ

Adezyon performansında zirve

TOTAL ETCH
ASİT KULLANILARAK UYGULAMA

SELF ETCH
ASİT KULLANILMADAN UYGULAMA

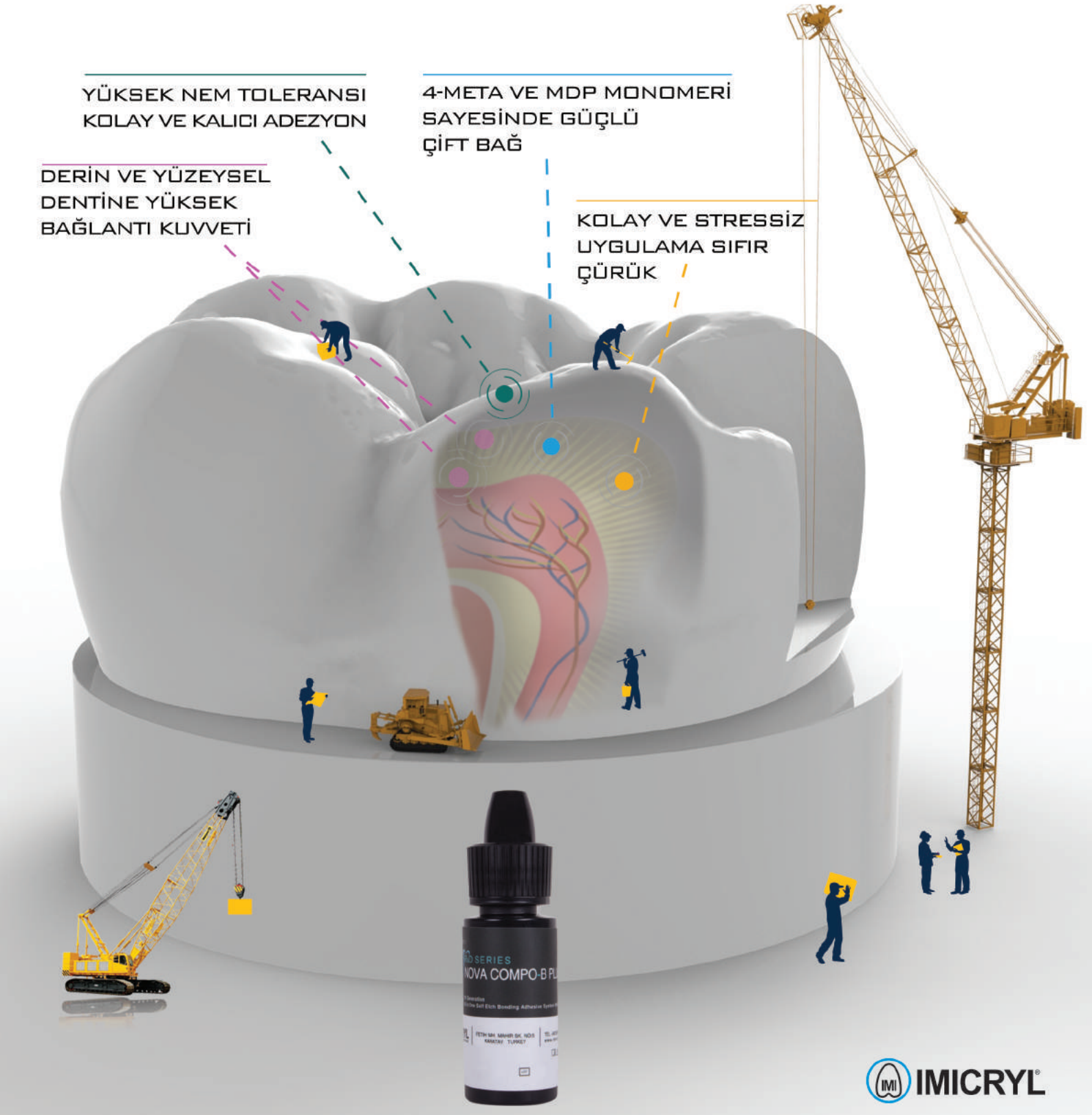
SELECTIVE ETCH
MİNEYE ASİTLİ, DENTİNE ASİTSİZ UYGULAMA

YÜKSEK NEM TOLERANSI
KOLAY VE KALICI ADEZYON

4-META VE MDP MONOMERİ
SAYESİNDE GÜÇLÜ
ÇİFT BAĞ

DERİN VE YÜZEYSEL
DENTİNE YÜKSEK
BAĞLANTI KUVVETİ

KOLAY VE STRESSİZ
UYGULAMA SIFIR
ÇÜRÜK



IMICRYL®

NOVA COMPO-B PLUS®

NOVA COMPO-B PLUS® ışıkla sertleşen etanol/su bazlı self etch, tek aşamalı all in one adeziv sistemidir. Direk ve indirekt restorasyonlarda total-etch, self-etch veya selective-etch uygulamalarında kullanılabilir.

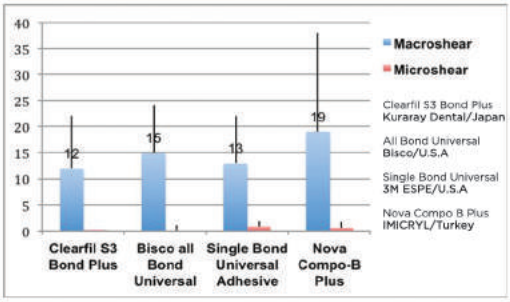
MDP monomerinin avantajları

- Mineye yüksek bağlantı kuvveti sağlar
- Self etch özelliğini artırır
- Ürünün raf ömrünü artırır
- Metale ve glass seramik içermeyen seramiklere yüksek bağlantı kuvveti gösterir
- Dişin yapısındaki Ca^{+2} iyonları ile çözünmeyen stabil bağ yaptığı için bondingin durabilitesi artmış olur

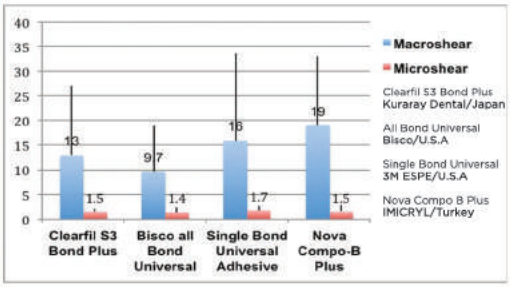
Karboksil grubu içeren adeziv monomerin avantajları

- Dentine bağlanmayı sağlar
- Dişin yapısındaki apatit ile bağ yapabilir
- Değişen nem koşullarında ve derin dentindeki bağlantı kuvvetini sağlar

NOVA COMPO-B PLUS®'ın muadil ürünlerle karşılaştırma çalışmaları

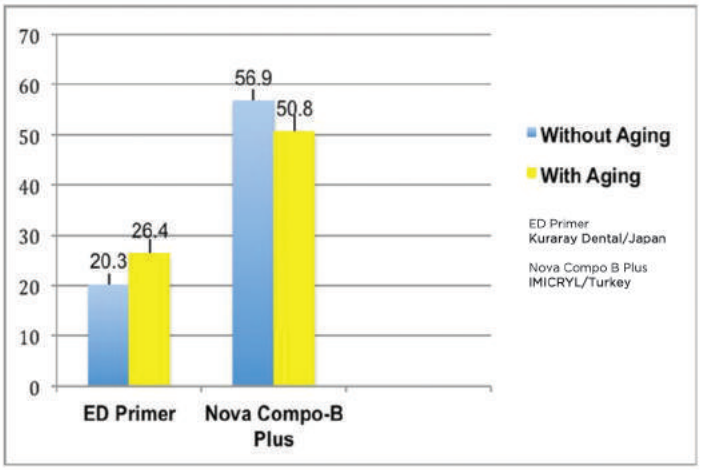


Farklı self-etch adheziv sistemlerin yüzeysel dentine makro ve mikro makaslama bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması.
Prof. Dr. Med. Dent. Mutlu Özcan, Ph.D University of Zürich



Farklı self-etch adheziv sistemlerin derin dentine makro ve mikro makaslama bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması.
Prof. Dr. Med. Dent. Mutlu Özcan, Ph.D University of Zürich

Farklı self-etch adheziv sistemlerin derin dentine mikro tensil bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması.



Prof. Dr.med.dent. Mutlu Özcan, Ph.D University of Zürich

Adhesive	Application Mode	Enamel
Single bond universal	Self-etching mode	14.99 ±2.7[a]
	Acid-etching mode	23.53 ±7.0[b]
	Er,Cr.YSGG laser-etch	17.15 ±4.4[a]
Nova Compo-B Plus	Self-etching mode	18.77 ±4.3[a]
	Acid-etching mode	23.70 ±4.9[b]
	Er,Cr.YSGG laser-etch	19.65 ±4.6[a]

Farklı universal adeziv sistemlerin mineye bağlantı kuvveti(çalışmada Valux plus/3M ESPE kullanılmıştır)

Dr.Muhammed Kerim Ayar, Biruni Üniversitesi
Dr.Fatih Erdemir, Karadeniz Teknik Üniversitesi

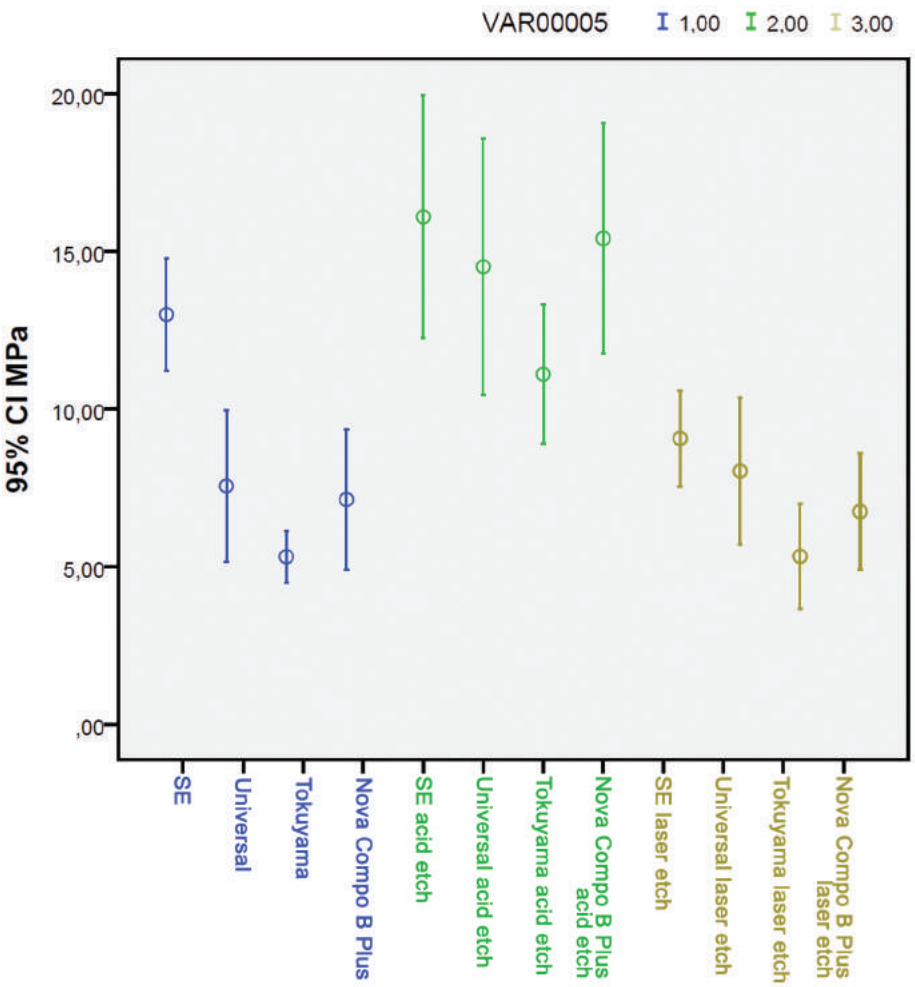
Single Bond Universal
3M ESPE/U.S.A

Nova Compo B Plus
IMICRYL/Turkey

Satın aldığınız üründeki güvenlik hologramına dikkat ediniz

www.imicryl.com.tr

+90 444 71 30



Farklı universal adeziv sistemlerin dentine bağlantı kuvveti (çalışmada Photo Posterior/ Kuraray kullanılmıştır)

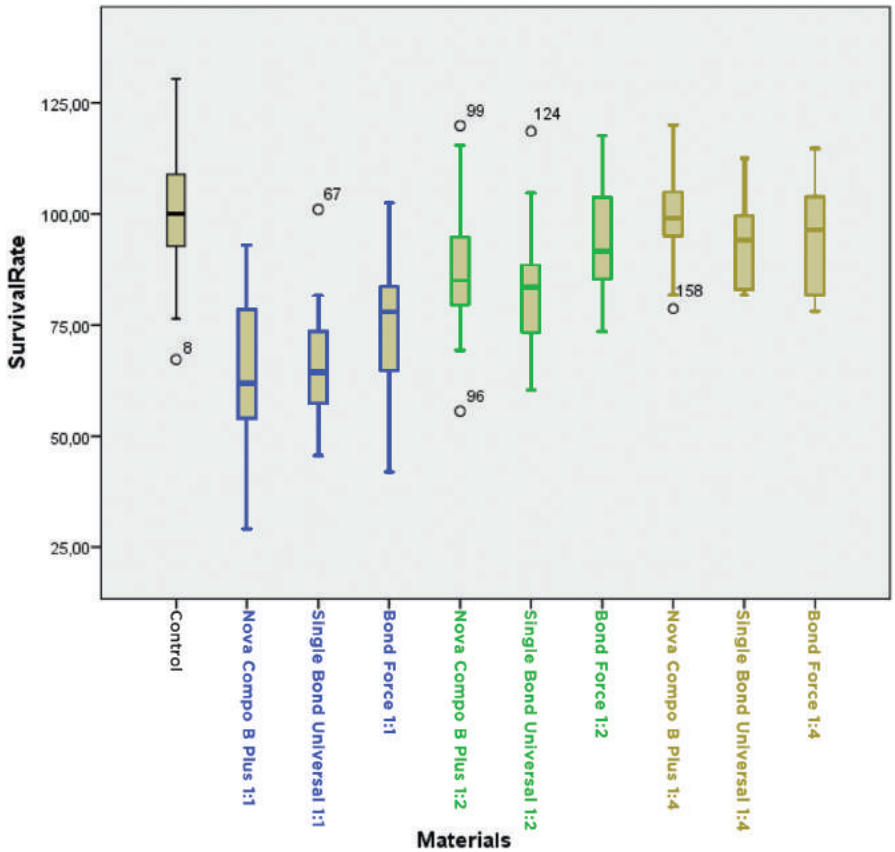
Doç.Dr.Mustafa Ülker

Nova Compo B Plus
IMICRYL/Turkey

Tokuyama
Bond Force Tokuyama/Japan

Universal
Single Bond Universal 3M ESPE/U.S.A

SE
Clearfil SE Bond Kuraray Dental/Japan



Üç farklı self-etch bonding adeziv sistemin biyouyumlulukları değerlendirilmiştir.

Doç.Dr.H.Esra Ülker
Selçuk Üniversitesi

Nova Compo B Plus
IMICRYL/Turkey

Single Bond Universal
3M ESPE/U.S.A

Bond Force
Bond Force Tokuyama/Japan

Satın aldığınız üründeki güvenlik hologramına dikkat ediniz

www.imicryl.com.tr

+90 444 71 30

IMICRYL®

Satın aldığınız üründeki güvenlik hologramına dikkat ediniz

www.imicryl.com.tr

+90 444 71 30